

Tagesordnung 1. Öffentlicher Statusworkshop des WK HIPS

Uhrzeit	Inhalt	Vortragender	Unternehmen / Einrichtung	Moderator	Bemerkungen
9:00	Eröffnung und Begrüßung	Dr. Knuth Baumgärtel	Micro-Hybrid electronic GmbH	Jens Müller TU Ilmenau	
	Grußwort TMWWDG	Staatssekretär Feller	TMWWDG		
	Grußwort TU Ilmenau	Prof. Sattler Präsident	TU Ilmenau		
	Grußwort LEG Thüringen	Andreas Krey Sprecher der Geschäftsführung	LEG		
09:30	Entwicklungstrends der Sensorik	Peter Krause	AMA		
10:00	Glasses and glass ceramic in electronic and sensor applications	Martin Letz	Schott AG		
10:30	Technologien zur Realisierung und Integration von MEMS-Komponenten	Roy Knechtel	HS Schmalkalden		
11:00	Kaffeepause				
11:10	Mit einem Quantensprung zu einer neuen Technologieplattform für Sensoren höchster Anforderungen	Franz Bechtold	VIA electronic GmbH	Olaf Brodersen Koordinierungsstelle	<u>Titel HIPS VP1:</u> Erforschung einer multifunktionellen Sub- strattechnologie (SiCer) für Sensoren höchster Leistung

Uhrzeit	Inhalt	Vortragender	Unternehmen / Einrichtung	Moderator	Bemerkungen
11:35	Pitch-Vorträge zu den Postern VP1, je Poster 2min.				
	Ausgewählte Prozesse der SiCer-Technologie	Thomas Handte	5microns GmbH	Franz Bechtold Via electronic	
	Entwicklung optimierter LTCC-Folien für den SiCer-Prozess	Clemens Motzkus	FHG IKTS		
	Entwicklung abgestimmter Metallisierungen für den SiCer-Prozess	Arno Görne	FHG IKTS		
	Structural Elements Integration in SiCer technology.	Ali Hajian	VIA electronic GmbH	Franz Bechtold Via electronic	
	Keramische Funktionswerkstoffe zur Integration in den SiCer-Prozess	Thomas Schulz	EAH Jena		
	Bearbeitung von SiCer- Substraten	Sebastian Gropp	TU Ilmenau		
	Lasermikrobearbeitung mit UltrakurzpulsLasern für SiCer Anwendungen	Robert Hebel	LLT Applikation		
	Modellierung und Simulation von Struktur- und Demonstratorelementen für SiCer-Anwendungen	Frank Spiller	IMMS GmbH		
	SiCerO - Eine Alternative Bondmethoden für Keramik-Si-Substrate	Laura Weidenfeller	TU Ilmenau		
11:55	Postersession VP1 für 9 Poster				
12:40	Mittagspause				
13:20	High Performance Flüssigkeitssensoren durch SiCer	Olaf Mollenhauer	Kompass GmbH	Olaf Brodersen Koordinierungsstelle	<u>Titel HIPS VP2:</u> High Performance Flüssigkeitssensoren durch SiCer

Uhrzeit	Inhalt	Vortragender	Unternehmen / Einrichtung	Moderator	Bemerkungen
13:45	Pitch-Vorträge zu den Postern VP2, je Poster 2min.				
	SiCer-Flüssigkeitssensorik: Applikationsbezogener Sensor- und Systementwurf	Olaf Mollenhauer	Kompass GmbH	Olaf Mollenhauer	
	Elektrostatischer Taupunktsensor auf Silicium-Basis	Thomas Handte	5microns GmbH		
		Pavel Muravyev	IL Mettronic GmbH		
	Reaktive Polymere für die schnelle Beschichtung von Fluidsensorelementen	Michael Gottschaldt	FSU Jena		
	Beschichtungen zur selektiven Steuerung bakterieller Initialadhäsion und Biofilmbildung für multi-sensorgesteuerte fluidische Applikationen	Steffen Czich	IBA Heiligenstadt		
	Biofilmdetektion und Mikrofluidik - Der Weg zur Durchflusszytometrie	Hans-Christian Fritsch	Ilmsens GmbH		
	Modulare Elektronikplattform mit Multi- Lambda-Sensoren für das Flüssigkeitsmonitoring	Sebastian Uziel	IMMS GmbH		
	Design und Aufbau eines Impedanzsensor- Moduls mittels SiCer-Technologie	Michael Fischer	TU Ilmenau		
	Einsatz von SiCer-Sensoren zur Optimierung photochemischer und photobiologischer Prozesse in einem neuartigen Hybridreaktor	Mathias Schröder	IFU GmbH		
	SiCer-basierte Flüssigkeitssensorik – Integration funktioneller und struktureller Designelemente mittels LTCC-Technologie	Peter Keil	VIA electronic GmbH		
14:05	Postersession VP2 für 9 Poster				
14:50	Kaffeepause				

Uhrzeit	Inhalt	Vortragender	Unternehmen / Einrichtung	Moderator	Bemerkungen
15:00	Entwicklung multifunktionaler Gas-Sensoren höchster Zuverlässigkeit auf Basis der SiCer-Verbundsubstrat-Technologie	Klaus Ettrich	CiS Forschungsinstitut	Olaf Brodersen Koordinierungsstelle	<u>Titel VP3:</u> Entwicklung multifunktionaler Gas-Sensoren höchster Zuverlässigkeit auf Basis der SiCer-Verbundsubstrat-Technologie
15:25	Pitch-Vorträge zu den Postern VP3, je Poster 2min.				
	Towards Robust Design and Processing for SiCer Substrates with Cavities	Uwe Krieger	VIA electronic GmbH	Klaus Ettrich CiS Forschungsinstitut	
	Anwendungen von SiCer-Substraten bei Drucksensoren	Andrea Cyriax	CiS Forschungsinstitut		
		Cathleen Kleinholz	TU Ilmenau		
	Dynamische Charakterisierung piezoresistiver Drucksensoren	Jens Scherbel	Lust Hybrid-Technik GmbH		
	Entwicklung von Technologiekomponenten für die Herstellung eines IR-Emitters in SiCer	Michael Fischer	TU Ilmenau		
	Entwicklung von IR-Sensorkomponenten in SiCer	Annett Isserstedt-Trinke	Micro-Hybrid Electronic GmbH		
	Aktiver Hochtemperatursensor bis 1.100°C	Matthias May	UST Umweltsensortechnik GmbH		
15:40	Postersession VP3 für 6 Poster				
16:25	Ende der Veranstaltung und kurze offene Diskussion	Knuth Baumgärtel	Micro-Hybrid electronic GmbH		